



BUSINESS REPORT 2017

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジインコーポレーテッド

社長あいさつ



平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2017年3月期の当社グループを取り巻く環境は、米国経済は景気回復の動きがみられ、日本・欧州経済は力強さを欠くものの景気の底堅さがみられましたが、中国では景気減速が継続しました。また、英国のEU離脱問題や米国新政権の動向の影響もあり、世界経済の先行きは不透明な状況が続きました。一方、世界半導体市場は、ロジックデバイス、メモリデバイスともに堅調な需要に支えられ、夏場以降、前年の実績を上回る形で推移し、成長基調となりました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めました結果、当連結会計年度の業績は、売上高33,092百万円(前期比4.2%増)、営業利益4,278百万円(前期比29.5%増)、経常利益4,519百万円(前期比35.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益3,350百万円(前期比42.8%増)となりました。

2017年3月期のトピックスとしましては、CMP向け製品の売上高が12,270百万円となり、これは、最先端ロジックデバイス向け製品およびメモリデバイス向け製品の販売が好調に推移したことによるものです。現在、フジミ台湾において、さら

なる売上の伸長を目指し前期より次世代向け製造ラインの拡張を進めております。また、米国においては、インテル社よりサプライヤー・コンテニューアス・クオリティーインブルーメント(SCQI)賞を受賞しました。本賞はインテル社が最も傑出したサプライヤーを表彰するもので、最先端ロジックデバイス向け製品で高い評価をいただいております、さらなる売上拡大に取り組んでまいります。

その他、昨年12月に厚生労働省の定める次世代育成支援対策推進法に基づいて策定した行動計画の計画内容を達成し、愛知労働局より「子育てサポート企業」として認定マーク(通称:くるみん)を初めて取得しました。従業員がその能力を十分に発揮できるように、子育て体制の充実を始め両立支援に取り組むを進めております。これからも従業員の子育てサポート体制の充実に一層取り組んでまいります。

最後になりますが、昨年11月に2022年3月期を最終年度とする中長期経営計画を策定しました。これまで築きあげた強固な財務基盤を背景として、成長のための既存・新規分野並びに当社コア技術の強化と新技術獲得へ向けた投資を積極的に行うと同時に株主の皆様への還元強化、CSR活動にも力を注いでまいります。株主の皆様への具体的な還元強化策として、目標とする連結配当性向を2019年3月期を目途に50%まで引き上げてまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。

2017年8月
代表取締役社長

関 敬史

プロフィール

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた当社製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP(化学機械平坦化)、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。

最近では、LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品等の硬脆材の表面加工分野やその他さまざまな表面加工のニーズに独自のソリューションで応える取り組みを積極的に進めております。また、溶射技術や装置に最適な溶射材の開発・商品化で新分野を開拓しております。

目次

社長あいさつ	1
経営方針	3
新中長期経営計画	5
研究開発活動	7
暮らしの中のフジミ	11
製造工程の中のフジミ	13
経営指標	15
連結貸借対照表	19
連結損益計算書	21
連結包括利益計算書	21
連結キャッシュ・フロー計算書	22
会社データ	23
株式情報	24
グローバル展開	25

Message from the President

In the fiscal year ended March 31, 2017, while experiencing an economic recovery in the US and slight improvement in Japan and Europe, China continued to face an economic slow-down. Furthermore, Brexit and a new administration in the US makes the world economic outlook increasingly uncertain. However, the global semiconductor market continued to pick up steam, with month-to-month sales modestly increasing since the summer, due to steady demands for logic and memory devices.

Under these circumstances, group-wide efforts were made to increase sales and reduce costs and the consolidated results for this period are as follows:

Millions of JPY

FY2017 Consolidated Results:

	FY ended March 31, 2016	FY ended March 31, 2017	Change YoY
Net Sales	31,755	33,092	4.2%
Operating Profit	3,302	4,278	29.5%
Ordinary Profit	3,342	4,519	35.2%
Profit Attributable to Owners of Parent	2,346	3,350	42.8%

Highlights for the year ended March 31, 2017, include the highest sales to date of products for chemical mechanical planarization (CMP), at JPY 12,270 million, overwriting the record of the previous term. The basis for this comes from the favorable sales of products for leading-edge logic and memory devices. Fujimi Taiwan is currently expanding its next-generation product line-up with hopes of a further sales increase since last year. Also, we received the Supplier Continuous Quality Improvement (SCQI) award from Intel Corporation. This is an award that Intel awards the most outstanding suppliers for their achievement of reaching extremely high standards. We are working to increase sales of products for leading-edge

logic devices.

In December 2016, we acquired the certification mark (known as: Kurumin) for “Corporations Supporting Parenting” for the first time by the Aichi Labour Bureau for achieving the content of the action plan derived from the Act on Advancement of Measures to Support Raising Next-Generation Children outlined by the Ministry of Health, Labour and Welfare. Our company strives to support initiatives that encourage our employees to focus both on work as well as parenting by creating a work-friendly environment so that all of our employees can exhibit their fullest potential. We will continue to further strengthen the support system for employees and their parenting needs.

Finally, in November 2016, we drew up our Medium & Long Term Business Plan, which is set to have the year ending March 31, 2022 as its final term. Based on the robust financial foundation that we have created to date, in the interest of growth, we will invest proactively in existing and new fields, as well as strengthen our core technologies and acquire new technologies. At the same time, we will augment shareholder returns as well as continue with activities focused on Corporate Social Responsibility. As one specific measure to boost shareholder returns, we are raising our consolidated dividend ratio target to 50% to be accomplished by the year ending March 31, 2019.

We are grateful for your patronage and ask for your continued understanding and support.

August 2017

Keishi Seki, President

Profile

Drawing on the know-how and R&D capabilities the company has accumulated since its founding, we have developed numerous products essential for leading-edge industries with high-precision polishing needs, including mirror polishing of semiconductor substrates like silicon wafers, CMP (Chemical Mechanical Planarization) required for the multilayer wiring of semiconductor chips, and computer hard disk polishing.

Recently, we have been actively pursuing unique solutions to address surface finishing needs for hard and brittle materials, such as parts used in LEDs, displays, and power electronics, as well as other types of materials. We have also been exploring new fields through the development and commercialization of optimal thermal spray materials for thermal spray technologies and devices.

Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Medium & Long Term Business Plan	6
Research and Development Activities	8
Fujimi's Products and Technology in Everyday Life	11
Fujimi's Products in Manufacturing Process	13
Selected Financial Data	15
Consolidated Balance Sheet	19
Consolidated Statement of Income	21
Statement of Consolidated Comprehensive Income	21
Consolidated Statement of Cash Flows	22
Corporate Data	23
Stock Information	24
Global Expansion	25

経営方針

はじめに

当社は「パウダー&サーフェス分野」を事業領域として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の品質化と安定供給に努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術の高度化に対して、迅速かつ的確に対応し、「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

企業理念

企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・一人ひとりが「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる会社を目指します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

行動規範

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・一人ひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

企業ビジョン

事業アイデンティティ

パウダー&サーフェス分野で世界最高技術を提供し、理想とする「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

企業文化ビジョン

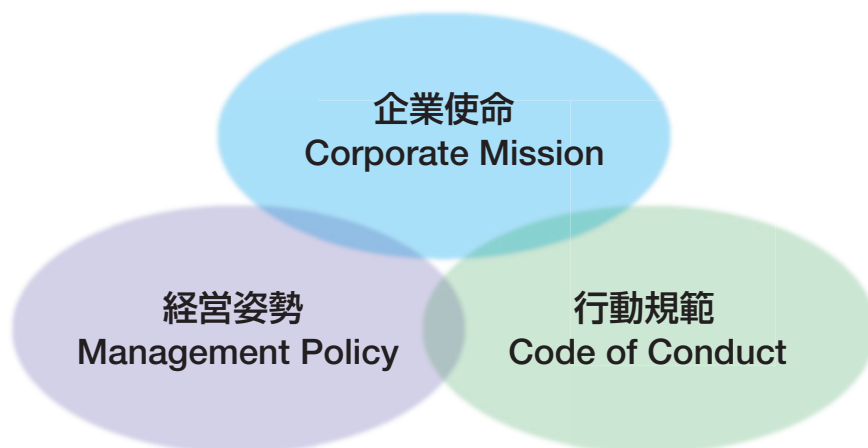
強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切に、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいただき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

企業理念 Corporate Philosophy



Management Objectives

Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered in powder and surface fields. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality products, a manufacturing approach from which we have

never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain same.

Corporate Philosophy

Corporate Mission

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

Management Policy

- We adopt the customer's point of view to create solutions that meet the customer's needs and expectations.
- We aim to be a company that motivates employees to excel by creating a great work culture.
- We excel in the ever changing business environment through innovation and continuous improvement.
- We adhere to rules and regulations and operate ethically, thereby strengthening our stakeholders' confidence and trust.

Code of Conduct

- We act with customer satisfaction in mind.
- We strive to identify the cause of an obstacle and to resolve it quickly.
- We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- We respect each person's ideas.
- We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

Corporate Vision

Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing environmental impact as a member of a recycling-based society.

Corporate Cultural Vision

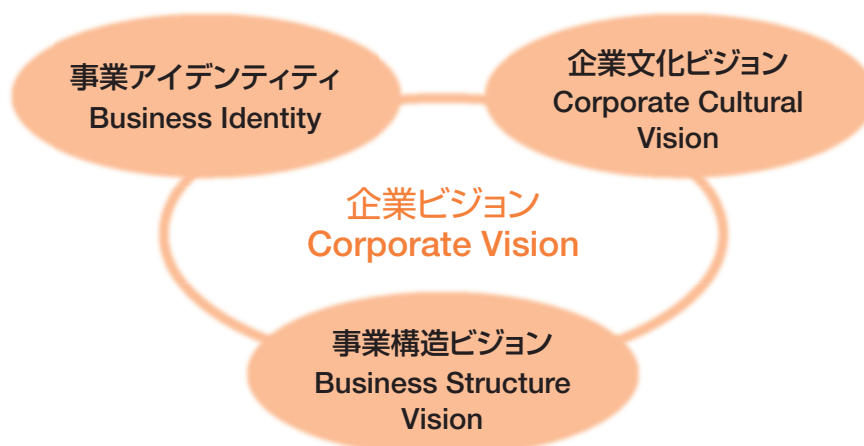
Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (Silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision



新中長期経営計画

2016年11月に新たな中長期経営計画を策定し、中長期ビジョンに「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」を据えました。これは、社員一人ひとりから自発的なアイデアとチャレンジが次々と生まれ、それを育む土壌を整えることで、環境の変化に対応し、企業文化ビジョンに掲げた「強く、やさしく、面白い」会社に向かっていくことを意図したものです。

当社はこれまで半導体市場を主たる事業領域とし、主に精密研磨材を開発・製造・販売してまいりましたが、事業環境の変化は激しさを増しています。長らく半導体市場の主役であったパソコンは2012年以降出荷台数の減少が続いており、その後市場を牽引してきたスマートフォンも既に成長率は大きく鈍化し、ポストスマートフォンに向けた新たな業界再編の動きが活発化しております。

こうした事業環境下で安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要であると考え、非半導体関連売上構成比の向上を目指してまいりました。一方で、当社は2012年に事業ドメインを「パウダー&サーフェス」と定めましたが、実際のところは従前同様に研磨材を中心とした事業活動が軸となっております。

中長期経営計画では、「パウダー&サーフェス」に加え、「表面加工のソリューション」へ事業ドメインの拡大を目指してまいります。具体的な取り組みとしては、短期から中期的には既存事業での深掘りと周辺領域の新規用途開拓を進め、中

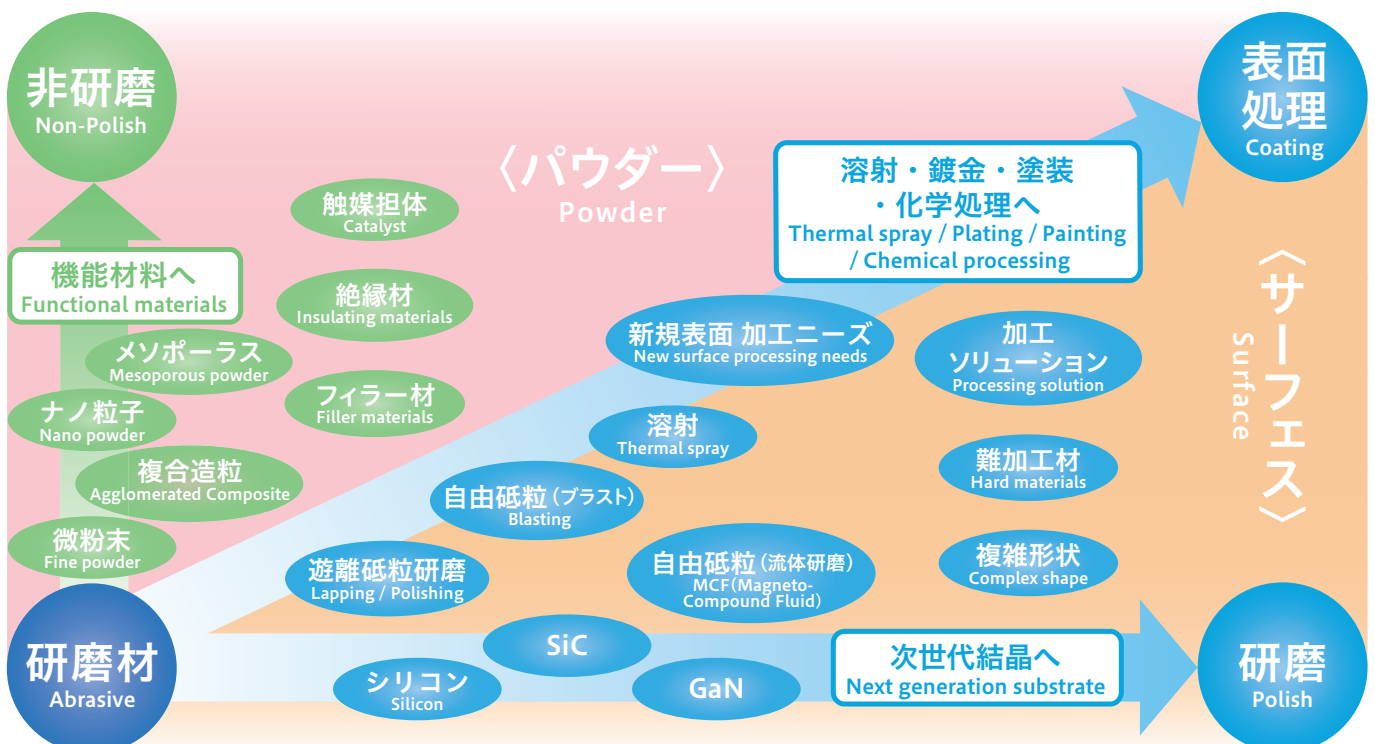
期的には「パウダー&サーフェス」を意識した非研磨用途・事業を拡充し、さらには10年先を見据えた長期視点での育成を進めてまいります。

なお、長期視点の活動につきましては、2015年4月に先端技術研究所を設置し、既に取り組みに着手しております。これまで築き上げた強固な財務基盤を背景として、引き続き成長のための積極的な開発投資を行ってまいります。

上記取り組み成果を測る指標として、非半導体売上構成比に加え、新規事業売上構成比、非研磨分野売上構成比についても目標を定め、定期的に進捗管理を行うことで、安定的かつ持続的な成長に繋げてまいります。

また、成長分野への積極投資と併せ株主の皆様への還元を強化（平成31年3月期までに配当性向を50%以上）することで資本効率（ROE、ROA）を高めると同時に、CSR活動においては、これまでの活動に加え、両立支援、女性活躍推進等にもより一層力を注ぎ、企業価値増大を目指してまいります。

研磨材メーカーから「パウダー & サーフェスカンパニー」へ Conversion from Abrasive Manufacture to "Powder & Surface" Company



Medium & Long Term Business Plan

In November 2016, we drew up a new Medium & Long Term Business Plan and set our Medium & Long Term Vision as “We support your forward-looking ideas and challenges.” This comes with the intent of striving towards a company that is “Strong, Kind and Exciting,” as stated in our Corporate Cultural Vision. This is realized by adapting to the changing environment made possible by cultivating the space for the growth of the voluntary ideas and challenges of each individual employee.

Until now, we have mainly developed, produced and sold precision abrasives with the semiconductor market as our main business area. However, the changing business environment is only getting more severe. Personal computers that have long been the key player of the semiconductor market, have seen a decline in shipments since 2012, and even smartphones that have held up the market since have seen a large slowdown in growth. Currently, there is increasing activity in industry reorganization in preparation for the post-smartphone era.

We believe a business structure that does not lean towards specific markets or needs is crucial in order to attain a stable and continued growth in such a business environment, and have thus aimed to improve our sales distribution ratio of non-semiconductor related items. On the other hand, although we established our business domain as “powder and surface” in 2012, in actuality, most of our activity was centered around abrasives as seen previously.

With the Medium & Long Term Business Plan, we aim to

expand our business domain to “polishing solutions” in addition to the current “powder and surface” area. In the short to mid term, we will expand existing business and develop new application of peripheral areas, while in the mid term, we will expand the application and business of non-polish with “powder and surface.” Furthermore, we hope to continue this growth with the long term, even 10 years.

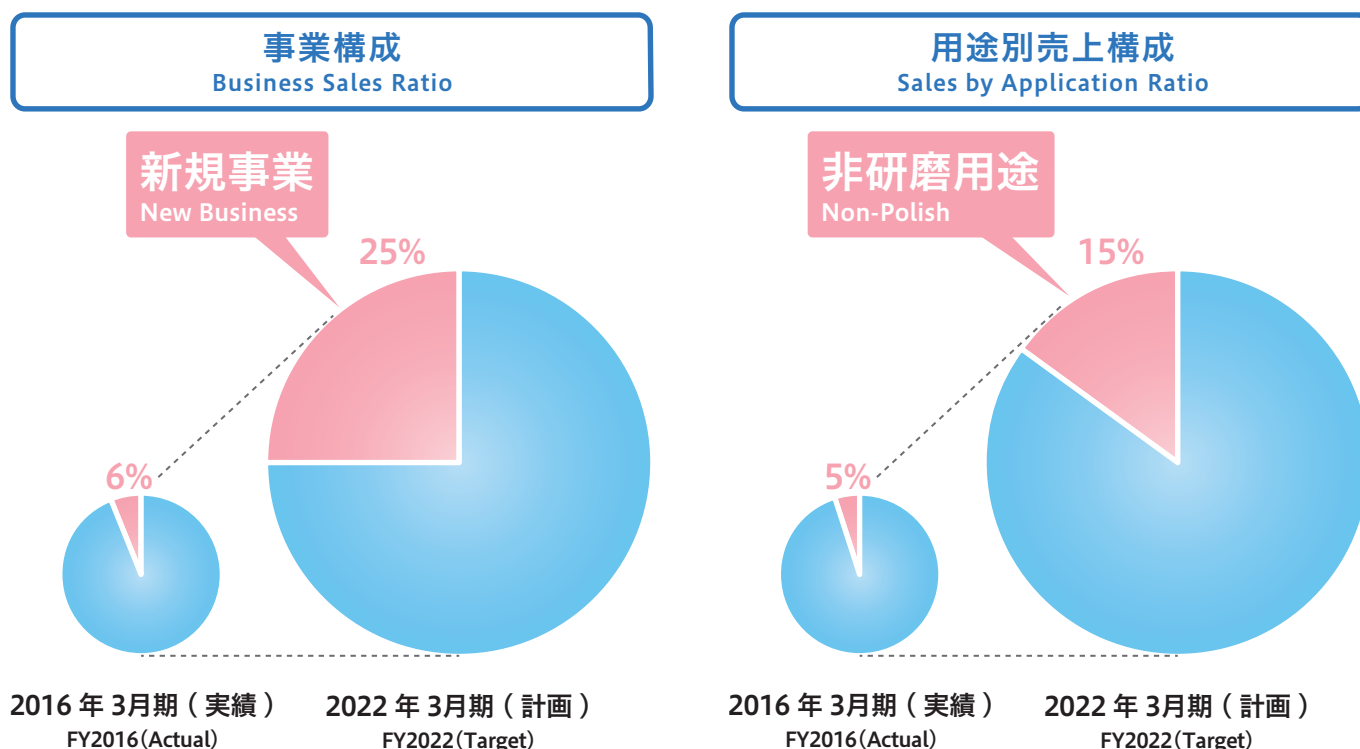
Also, we have begun working on long term activities by setting up the Advanced Technology Research Center in April 2015. We will continue proactive development investments to achieve continuous growth with our solid financial base.

As an index for measuring the success of the above endeavors, we are striving for stable and continuous growth by periodically managing progress through setting goals for the sales distribution ratios for new businesses and the sales distribution ratios for non-abrasive areas, on top of those of non-semiconductors.

We will strive to largely increase our corporate value by strengthening the return to our shareholders coupled with our active investments in growing areas (over 50% payout ratio by year ending March 31, 2019), increase capital efficiency (both ROE and ROA), and place more effort into promoting female activity and work-parenting support as part of our CSR activities.

事業領域の拡大 ～新規事業・非研磨用途の拡充～

Expansion of Business Areas – Expand New Business and Non-Polish Business –



研究開発活動

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコア技術となる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査探索機能の強化に努めております。

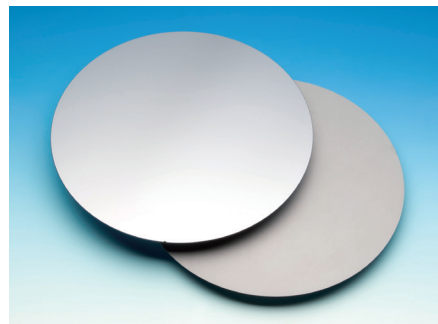
シリコンウェハー

300mm シリコンウェハーの需要拡大、デザインルールの微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①高平坦化、②高平滑化、③無欠陥化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっております。

高平坦化や生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工力、加工精度および加工歩留まり向上を共に満足する製品の検討を進めております。

一次研磨工程用スラリーとしては、ウェハー中心部から最外周部まで超平坦に加工できる差別化製品から、高速研磨型やリサイクル性付与型等お客様の生産性向上につながる製品までを、また、最終仕上げ研磨工程用スラリーでは、配線間隔が10nm 台のウェハー研磨用として研磨後表面のナノ欠陥を激減し原子レベルの平滑性を実現するポリシング材の開発を、砥粒・添加剤設計、配合技術を応用しながら取り組んでおります。

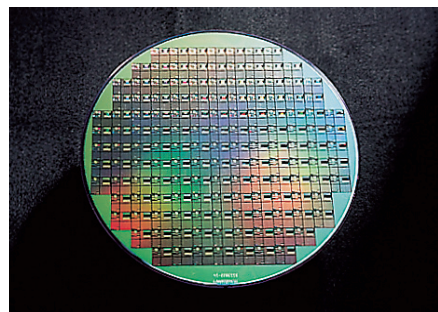
さらには、近年次世代パワーデバイスとして SiC や GaN 系の半導体が注目されております。これら難加工基板用研磨材の研究開発も進めており、高速・高面質となる新たな製品・プロセス開発に取り組んでおります。



半導体デバイス

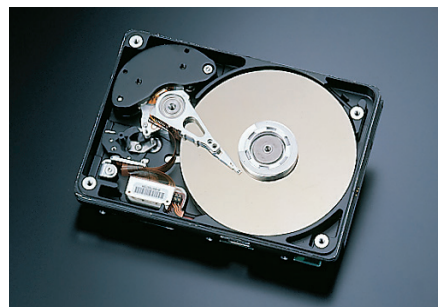
先端の半導体デバイスの微細化が進展し、ロジックデバイスではテクノロジーノード10nm のデバイスが量産化され、7nm 以降のデバイスの研究開発が活発化しております。微細化の進展に伴い、Fin FET と呼ばれる3次元構造のトランジスタが使われています。また、NAND 型フラッシュメモリにおいては3次元に積層し、高密度化した3D NAND と呼ばれるフラッシュメモリの量産が拡大しております。さらには、DRAM や異種のデバイスを3次元に実装するためにスルーシリコンビア (TSV) 技術の量産適用も始まっております。これらの新トランジスタや新構造の形成においても、CMP プロセスが適用され、その用途はますます広がりつつあります。

当社では、多結晶シリコン薄膜用や Cu 配線形成用にポリシング材を開発しておりますが、上記のような CMP プロセスの用途拡大にあわせ、新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めております。微細化、高密度化とともに高度化するお客様の要求にお応えするため、当社では最先端の研磨装置、評価装置、分析装置を活用すると同時に当社の砥粒技術、ケミカル技術などを活かした研究開発を行っております。



ハードディスク

増大していくデジタルデータの保存要求量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速されています。現在、ハードディスク基板はナノレベルの欠陥が問題とされており、欠陥数および欠陥サイズの低減要求はさらに厳しくなっております。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動により新製品の開発を推進しております。



Research and Development Activities

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is the core technology for our growth. We are working to strengthen our research and seeking functions on technology-based new business and topics.

Silicon Wafers

As there is an increase of demand for 300mm silicon wafers in the market, as well as a further shrinking of design rules, requirements of super precise polishing for 1) high flatness, 2) low roughness, 3) defect free, 4) metal contamination free and 5) productivity improvement are getting stronger and stronger.

For the application of silicon lapping and slicing abrasives, for which high flatness and high productivity are needed, we are proceeding with activities to satisfy the cutting rate, quality and yield for customers.

For the application of silicon stock polishing slurry, we are exclusively developing new products, not only to produce a super flat silicon wafer from the wafer center to the furthest area on the periphery, but also to enhance the productivity for customers through a high stock removal rate and longer recyclable slurry. And for the application of the final polishing slurry to meet a 10nm level node, we are also developing new products that can reduce nanometer-sized defects drastically and improve the atomic level roughness after polishing based on abrasive/additive design and formulation technology.

Furthermore, SiC and GaN semiconductors have recently been focused on as next-generation power devices. We are proceeding with R&D activities on the slurry for such a hard material and are working to develop a new product/process for a high removal rate with a high surface quality.

Semiconductor Devices

As the shrinking of leading-edge semiconductor devices is progressing, the mass production of 10nm technology nodes for logic devices and the research and development for devices smaller than 7nm are actively moving forward. Alongside the shrinking trend, a new kind of transistor with a 3D structure, known as a FinFET, is being used. Also, the NAND flash memories are now laminated in 3 dimensions, while mass production for further high-density flash memory called 3D NAND is expanding. Furthermore, the mass production of Through Silicon Via (TSV) technology that mounts DRAM and other types of devices in 3 dimensions is underway. The CMP process is applied to forming these new transistors and new architectures as well with the strong prospect of expanding its use.

Although we have already developed slurries for polycrystal silicon films and Cu wiring, we have also launched development of slurries that can be used with new materials and structures to expand the use of the CMP process as mentioned above. We are employing state-of-the-art polishing, evaluation, and analysis equipment, and applying proprietary polishing and chemical technologies to research and development operations in order to meet customer requirements for higher levels of shrinking densification and sophistication.

Hard Disks

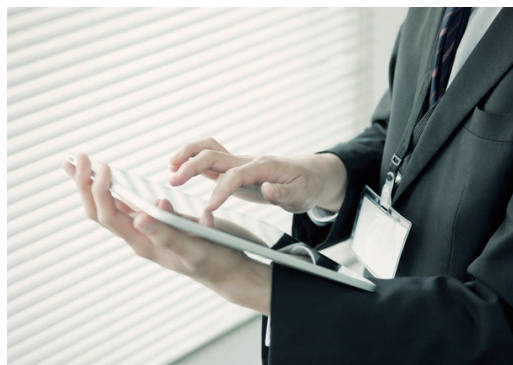
The development of next generation hard disks has been accelerated for the required storage of increasing digital data. Today, the requirements for fewer and smaller defects are getting severer than ever, as nanometer-level defects are considered problems for the hard disk substrates. To meet these requirements, we have been driving new product developments through activities together with our customers.

機能材

LT/LN、プラスチックレンズ、ガラスなど多種多様な表面に適した研磨材および原材料となる微粒子の開発に取り組んでおります。お客様のご要求を的確に捉え、当社のコア技術を活用してお客様にご満足いただける製品の開発を推進しております。

新規事業

半導体、ハードディスク用途など既存事業用途以外の新規用途(例:LED、ディスプレイ、モバイル用途など)で用いられる、金属、セラミック、樹脂などの多種多様な材質、またさまざまな形状に適した一般工業用部品の研磨材等の開発に取り組んでおります。新規の用途では、研磨材のみならず、用途に応じた装置や周辺消耗材の推奨も含めた、加工プロセスの開発・提供も必要とされております。世界のさまざまな業界のお客様から寄せられる表面創成ウオントツに、トータルソリューションでお応えしてまいります。



溶射材

省資源化、高効率化要求が高まっている現代社会において、航空機、半導体、一般産業機械など多岐にわたり高機能皮膜への要求は高まってきており、溶射皮膜の用途拡大が期待されております。近年の溶射プロセスでも、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めております。これら市場の期待に応えるべく、複合造粒技術やスラリー化技術などを活かした最適な溶射材の開発に重点を置き推進してまいります。

先端技術研究所

先端技術研究所は、1) 基幹技術開発(基盤技術を強化し深耕、新規技術の開発)、2) 開発企画(新規事業機会の創出と育成)、3) 事業企画(M&A、ベンチャー企業投資の実行と推進)の3つを遂行するため2015年4月に設立しました。それ以降、展示会や学会、大学、公的な研究機関などと連携活動を活発化し、“パウダー&サーフェス”分野での新規事業に結びつくテーマ探索に努めてまいりました。それら活動の結果、現在は非半導体・非研磨分野において、幾つかの新規研究開発テーマで外部との共同開発を開始しております。

さらに2015年11月にベンチャー投資組合を設立し、2016年度は有望なベンチャー企業3社への投資を実行しました。

本年もこれらの活動を推進し、新規事業の創出に努めてまいります。

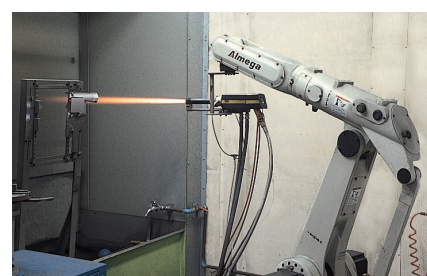
さまざまな産業



さまざまな課題



さまざまな加工対象



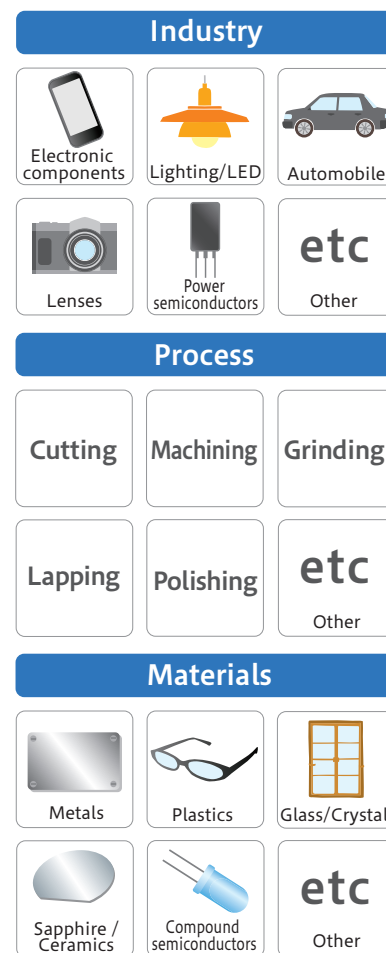
Specialty Materials

We have been developing polishing agents and microparticles for raw materials of the polishing agents suitable for various surfaces, such as LT/LN, plastic lenses and glass. To grasp customer's requirements accurately, we promote the development of products that can satisfy customers by utilizing our core technologies.

New Business

We are developing abrasives and other products for a wide variety of industrial components made of metal, ceramic and resin for new applications (e.g., LEDs, displays, mobile device, etc.) other than semiconductor, hard disk and other applications covered by existing business.

To speak to new applications, on top of abrasive products, development and provision of total manufacturing process are also necessary along with the recommendation of application-specific equipment and consumables. We will continue to serve the new surfacing requests of customers from all walks of industry and location by providing total solutions.



Thermal Spray Materials

In today's world of increasing demand for resource conservation and higher efficiency, there is a growing need for highly functional films across a wide range of products, such as aircrafts, semiconductors and general industrial equipment; thus, broader use of thermal spray films is expected. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are "lower temperatures" and "micronization," as means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, we are stepping up our development of appropriate thermal spray materials by applying our compounding, granulation and slurring technologies.

Advanced Technology Research Center

The Advanced Technology Research Center was established in April 2015 in order to achieve the following three tasks: (1) Develop foundational technology (strengthens and deepens core technologies while also developing new technology); (2) Plan development (creates and fosters new business opportunities); and (3) Plan businesses (execute and promote M&A and venture business investments). Since then, we have been striving to explore themes that can connect to new businesses in the powder and surface fields by actively promoting exhibitions, academic conferences and collaborative activities with universities and public institutions. As a result of such activities, we have now begun joint development with external companies on new research and development themes in multiple fields regarding non-semiconductors and non-abrasives.

Furthermore, we established a venture investment fund in November 2015, and invested in three high-potential venture companies in FY2016.

This year, we will continue to promote these activities and make an effort to have new businesses.

暮らしの中のフジミ

Fujimi's Products and Technology in Everyday Life

フジミの製品は、生活の中のさまざまな物に使われています。
Fujimi's products are used for various items that people see and use in everyday life.



飛行機 Aircraft

ココにも



フラップ・スラット
レールに溶射材が
使われています。

Thermal Spray materials
are used for flap-slat
rails.



ココにも FUJIMI 鉄道 Railroads

車両の中の IC チップ製造
過程で FO、GLANZOX、
PLANERLITE 等が使われ
ています。

FO, GLANZOX and
PLANERLITE are used for
manufacturing process of
IC chips placed in rolling
stock.



信号機 Traffic lights

ココにも



サファイア基板を
磨く過程で COMPOL
が使われています。

COMPOL is used for
manufacturing process
of sapphire substrates
placed in LED lamps.



ココにも FUJIMI スマートフォン Smartphones

部品の中の水晶振動子
製造過程で GC が使われ
ています。

GC is used for manufacturing
process of crystal oscillators
placed in smartphones.

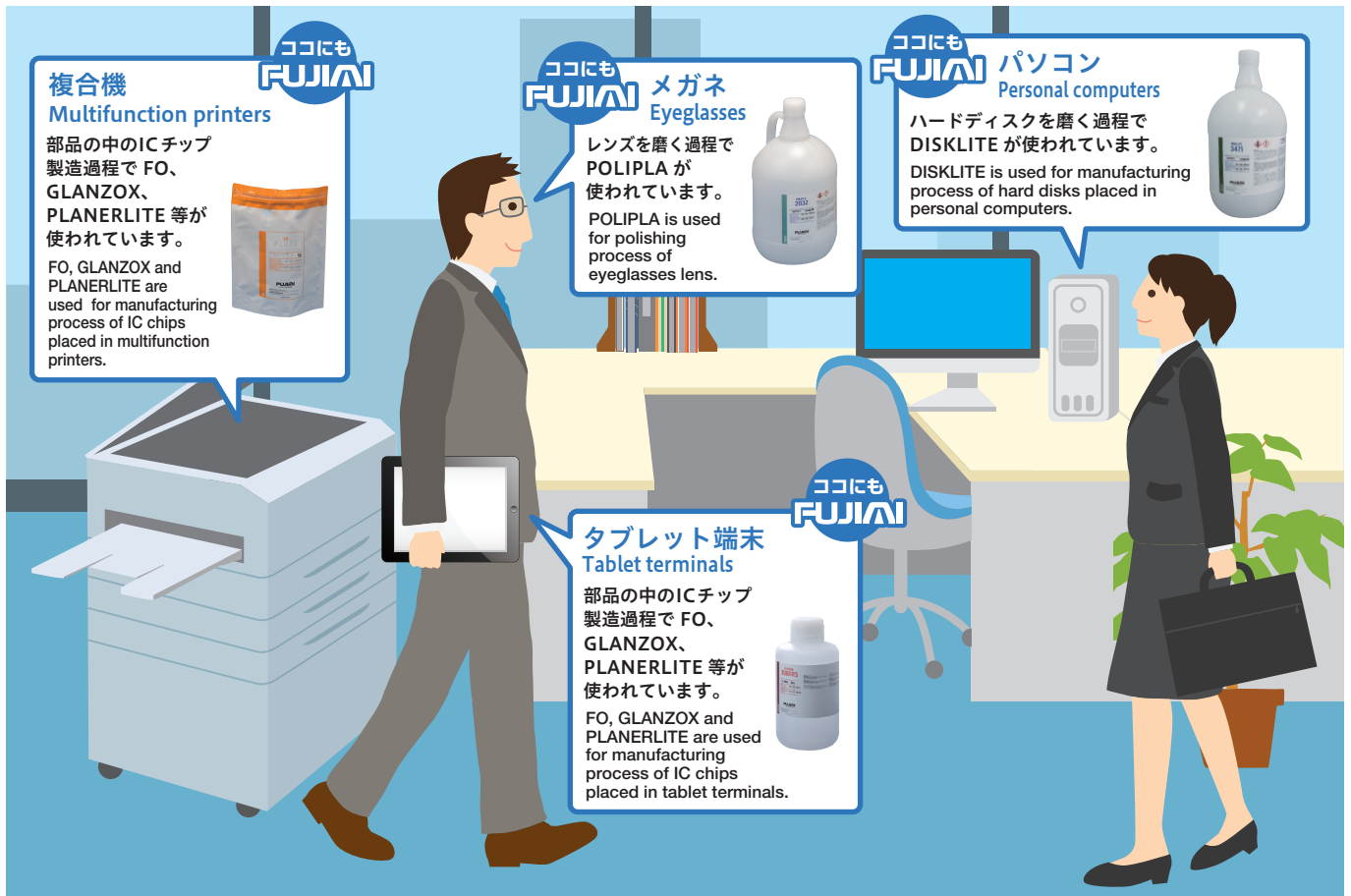


ココにも FUJIMI 自動車 Automobiles

ボディを磨くのに
GC、WA が使われています。

GC and WA are used for
polishing process of
automobile bodies.





ココにも FUJIMI

複合機
Multifunction printers

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。

FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in multifunction printers.



ココにも FUJIMI

メガネ
Eyeglasses

レンズを磨く過程で POLIPLA が使われています。

POLIPLA is used for polishing process of eyeglasses lens.



ココにも FUJIMI

パソコン
Personal computers

ハードディスクを磨く過程で DISKLITE が使われています。

DISKLITE is used for manufacturing process of hard disks placed in personal computers.

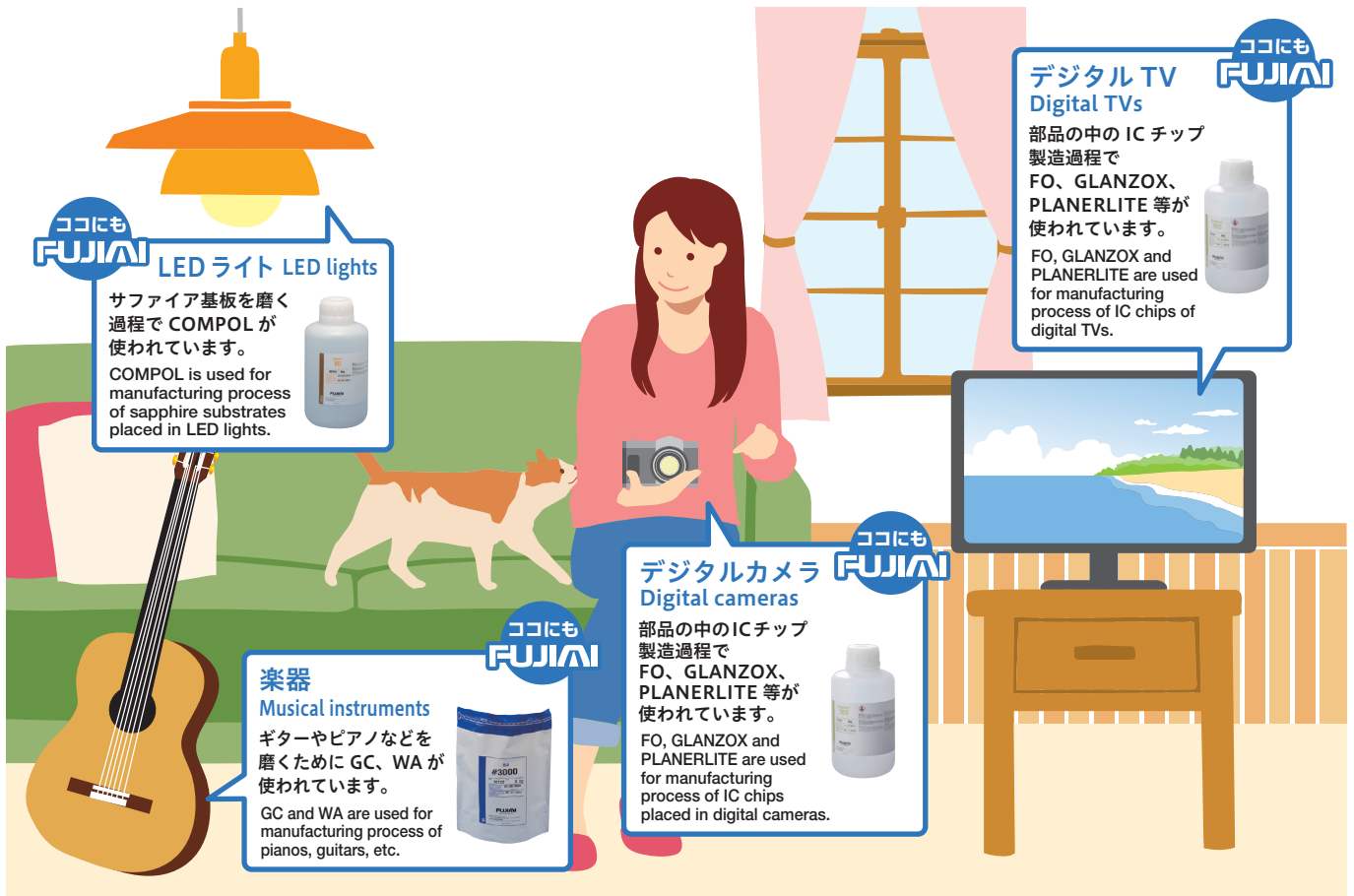


ココにも FUJIMI

タブレット端末
Tablet terminals

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。

FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in tablet terminals.



ココにも FUJIMI

LEDライト LED lights

サファイア基板を磨く過程で COMPOL が使われています。

COMPOL is used for manufacturing process of sapphire substrates placed in LED lights.



ココにも FUJIMI

デジタルTV
Digital TVs

部品の中の IC チップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。

FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips of digital TVs.



ココにも FUJIMI

デジタルカメラ
Digital cameras

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。

FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in digital cameras.



ココにも FUJIMI

楽器
Musical instruments

ギターやピアノなどを磨くために GC、WA が使われています。

GC and WA are used for manufacturing process of pianos, guitars, etc.



製造工程の中のフジミ

Fujimi's Products in Manufacturing Process

半導体デバイス製造に使われるフジミの製品

Fujimi's products used for semiconductor device production

インゴット引き上げ Crystal Pulling

インゴット Ingot
るつぼ Crucible

シリコンインゴットの切断 Cutting the silicon ingot

ワイヤソーでの切断 Cutting by a wire saw
研磨材 Abrasives

フジミの研磨材はココに使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

単結晶シリコンインゴットをウェハーにスライスします。
Single crystal silicon ingot is sliced into wafers.

ラッピング工程 Lapping Process

定盤(上) Upper Platen
研磨材 Abrasives
ウェハー Wafer
定盤(下) Lower Platen

フジミの研磨材はココに使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

シリコンウェハー表面の粗さを整えます。
Surface roughness of silicon wafers are reduced.

ポリシング工程 Polishing Process

ヘッド Head
ウェハー Wafer
研磨パッド Polishing Pad
ポリシングスラリー Polishing slurry

フジミの研磨材はココに使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

シリコンウェハー表面を鏡面状に磨き上げます。
Wafers surfaces are mirror-polished.

CMP工程 CMP Process

ヘッド Head
ウェハー Wafer
研磨パッド Polishing Pad
CMPスラリー CMP slurry

スラリーを流しながら、ヘッドに保持されたウェハーの表面を、研磨テーブル表面の研磨パッドに接触させて研磨します。
While slurry is being poured, the surface of the wafer, which is fixed to the head, is polished by contacting it with the polishing pad mounted on the surface of a polishing table.

フジミの研磨材はココに使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

堆積された膜の凹凸をCMPによって平坦化します。
The irregularities of accumulated films are flattened in the CMP process.

フォトリソグラフィ工程 Photolithography Process

光源 Light source
照明系レンズ Illumination lens
フォトマスク Photomask
投影レンズ Projection lens
移動 Move
ステージ Stage

フォトレジスト(感光剤)をウェハー表面に塗布し、回路パターンが描かれたフォトマスクをウェハーに焼きつけます。その後、不要な酸化膜やレジストをエッチングして取り除くとパターンの完成です。
Photoresist (photosensitizing agent) is applied to the wafer surface and the circuit pattern-printed photomask is baked onto the wafer. Afterwards, oxide film and resist are removed by etching to complete the pattern.

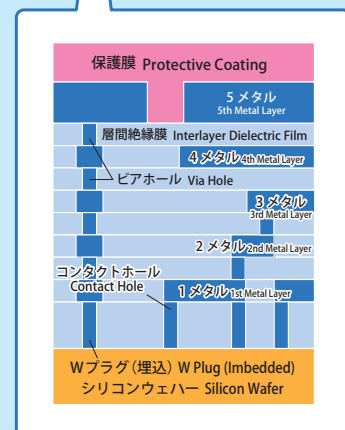
繰り返し Repetition

組み立て Assembling

デバイスウェハー Patterned wafer
ダイヤモンドソー Diamond Saw
パッケージ Package
ICチップ IC chip
リードフレーム Lead frame

ダイヤモンドソーでウェハーを縦横にカット
The diamond saw slices a wafer into pieces.

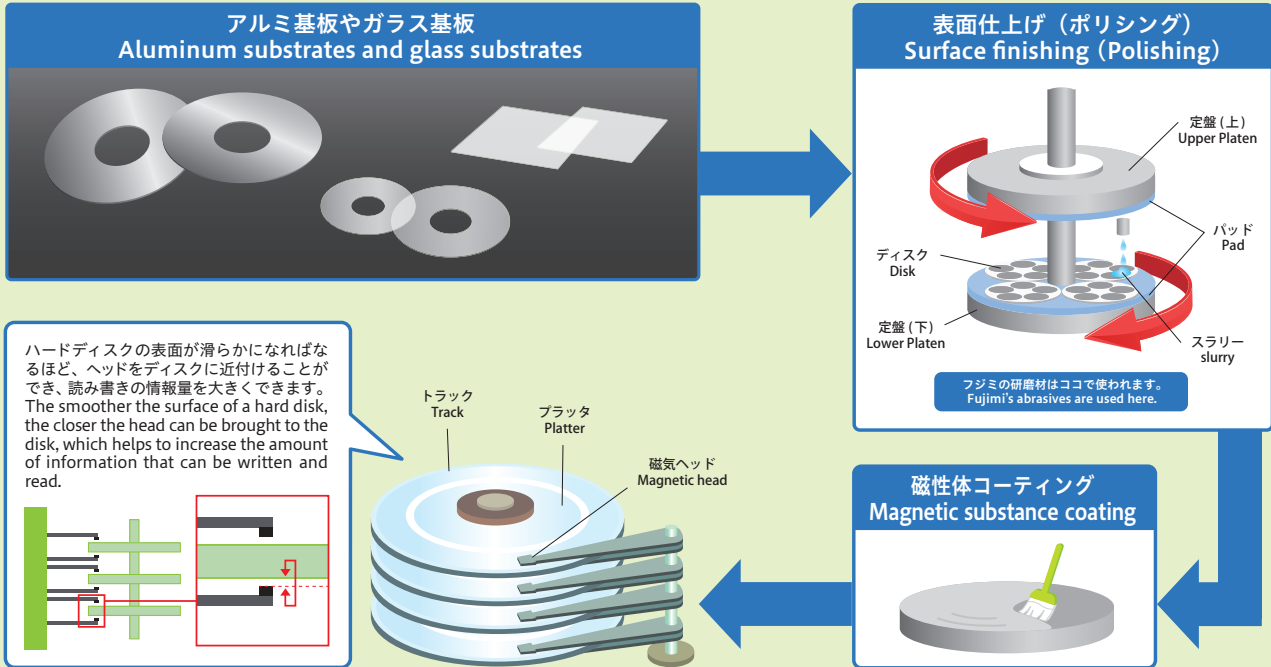
ウェハーをチップに切り分け、パッケージングして出荷します。
The wafer is cut into pieces and shipped after packaging.



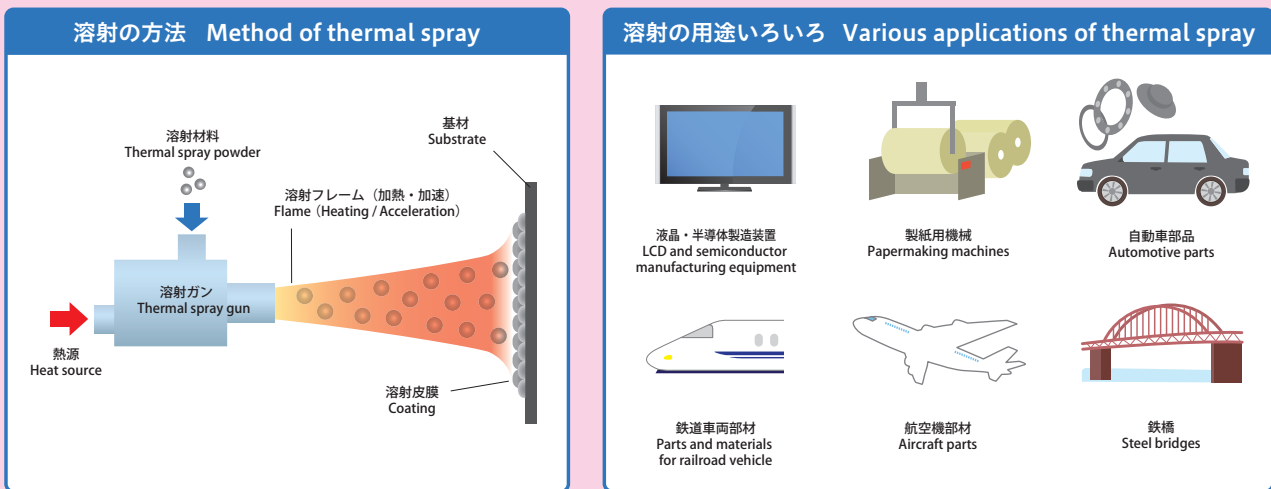
この工程を12~14回繰り返し、多層配線を形成します。
This process is repeated 12 to 14 times to form multi-layer interconnections.

※イラストはイメージです。実際の工程とは異なることもあります。
The illustrations are only example images. The actual process may vary from the illustrations.

ハードディスクの構造 Structure of hard disks



溶射と色々な用途 Thermal spray and various applications



溶射材料を溶射フレームに投入し、基材へ衝突、堆積させることで機能性皮膜を作製する。
Thermal spray powder is supplied into the flame, then deposited on the substrate to form functional coatings.

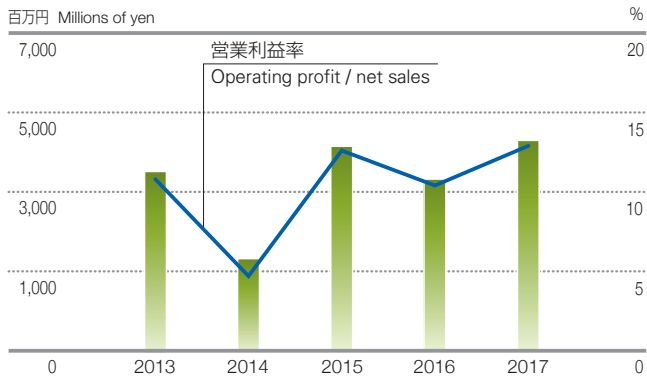
過酷な条件下で使用される機械部品や構造物を熱や腐食、摩耗から守り、長持ちさせる目的で使われる溶射材。その用途は、鉄道や液晶・半導体製造装置や発電に利用されるガスタービン、製紙用機械や鉄橋など多岐にわたっています。
Thermal spray is used to protect machine parts and structures that are used under extreme conditions against heat, corrosion, and abrasion, and to make them durable. Thermal spray is applied to a variety of fields including railroads, LCD and semiconductor manufacturing equipment, gas turbines for power generation, papermaking machines and steel bridges.

経営指標 Selected Financial Data

収益性 Profitability

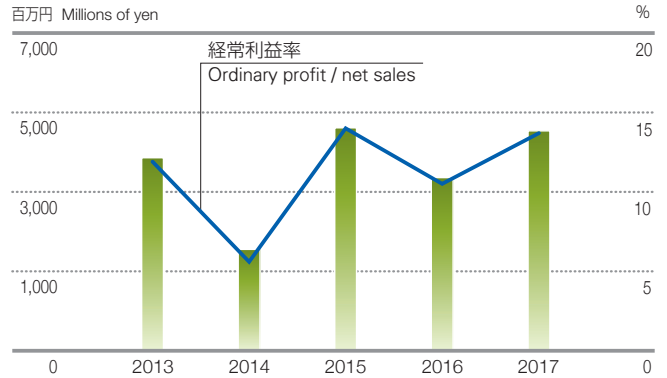
営業利益/営業利益率

Operating Profit and Operating Profit / Net Sales



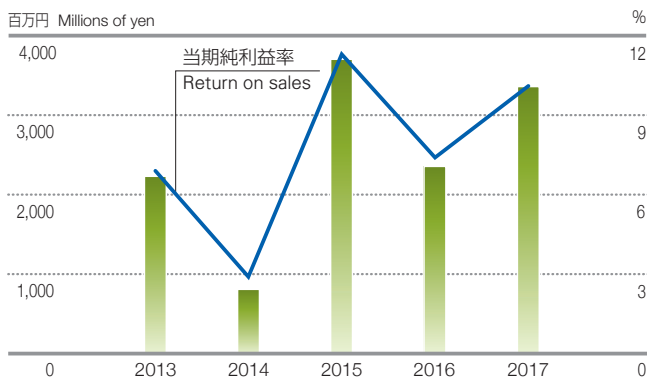
経常利益/経常利益率

Ordinary Profit and Ordinary Profit / Net Sales



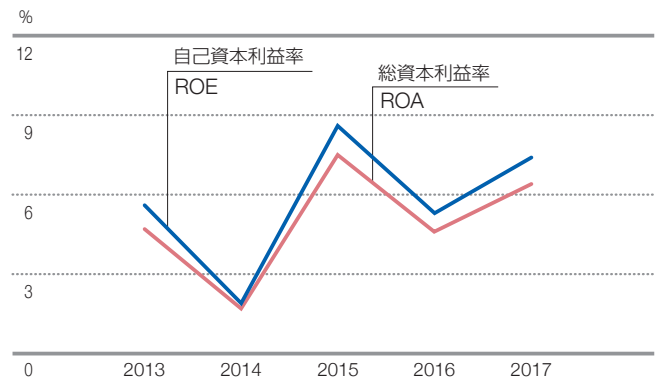
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率

Profit Attributable to Owners of Parent and Return on Sales



自己資本利益率/総資本利益率

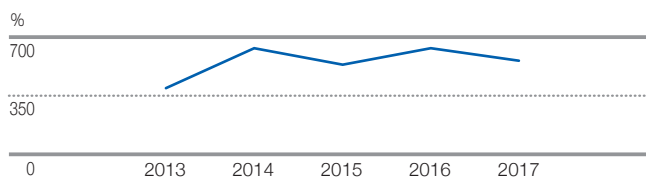
Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



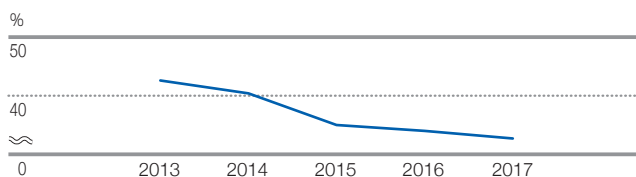
				3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				
				2013	2014	2015	2016	2017
売上高	百万円	Net sales	Millions of yen	32,412	27,492	32,815	31,755	33,092
営業利益	百万円	Operating profit	Millions of yen	3,496	1,300	4,128	3,302	4,278
営業利益率	%	Operating profit/net sales	%	10.8	4.7	12.6	10.4	12.9
経常利益	百万円	Ordinary profit	Millions of yen	3,843	1,535	4,596	3,342	4,519
経常利益率	%	Ordinary profit/net sales	%	11.9	5.6	14.0	10.5	13.7
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	Profit attributable to owners of parent	Millions of yen	2,222	799	3,695	2,346	3,350
当期純利益率	%	Return on sales	%	6.9	2.9	11.3	7.4	10.1
自己資本利益率 (ROE)	%	Return on equity	%	5.6	1.9	8.6	5.3	7.4
総資産利益率 (ROA)	%	Return on assets	%	4.7	1.7	7.5	4.6	6.4

安定性 Stability

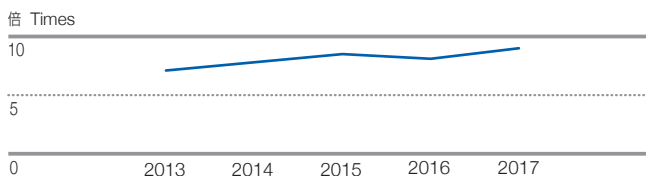
流動比率 Current Ratio



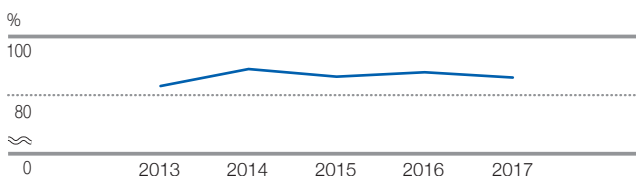
固定比率 Non-current Assets Ratio



手元流動性比率 Short-Term Liquidity



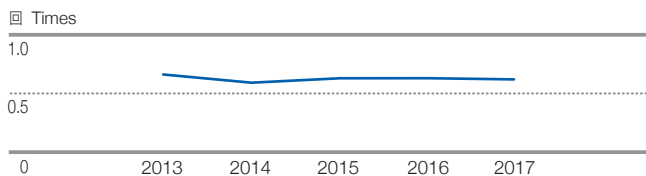
自己資本比率 Equity Ratio



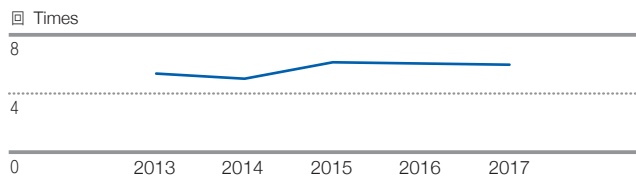
			3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				
			2013	2014	2015	2016	2017
流動比率	% Current ratio	%	395.1	634.3	535.3	633.7	558.9
固定比率	% Non-current assets ratio	%	42.6	40.4	35.0	34.0	32.7
手元流動性比率	倍 Short-term liquidity	Times	7.1	7.8	8.5	8.1	9.0
自己資本比率	% Equity ratio	%	83.1	88.9	86.3	87.8	86.0

生産性 / 効率性 Productivity and Efficiency

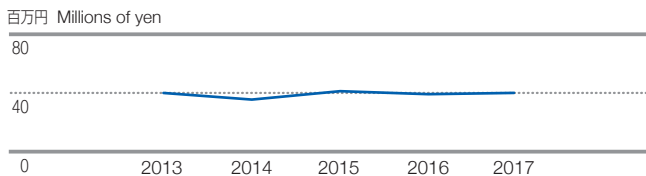
総資本回転率 Total Asset Turnover



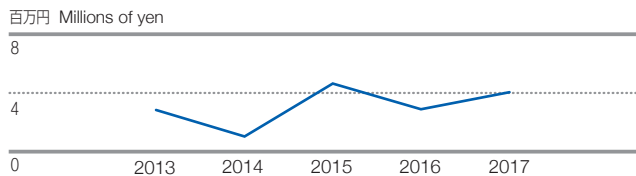
たな卸資産回転率 Inventory Turnover



従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



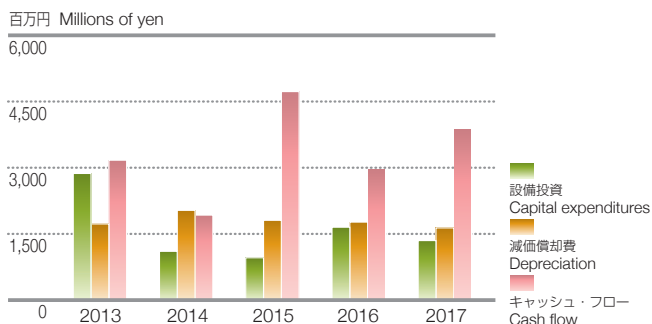
従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee



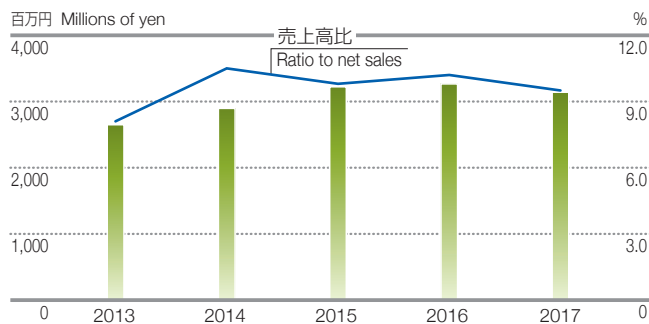
			3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				
			2013	2014	2015	2016	2017
総資本回転率	回 Total asset turnover	Times	0.66	0.59	0.63	0.63	0.62
たな卸資産回転率	回 Inventory turnover	Times	5.36	5.01	6.13	6.05	5.96
従業員1人当たり売上高	百万円 Net sales per employee	Millions of yen	41.39	35.47	41.12	39.16	40.02
従業員1人当たり当期純利益	百万円 Net income per employee	Millions of yen	2.84	1.03	4.63	2.89	4.05
従業員数	人 Number of employees		783	775	798	811	827

設備投資 / 研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

設備投資/減価償却費/キャッシュ・フロー Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/売上高比 R&D Expenses and Ratio to Net Sales



3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				2013	2014	2015	2016	2017
設備投資	百万円	Capital expenditures	Millions of yen	2,856	1,094	947	1,637	1,336
減価償却費	百万円	Depreciation	Millions of yen	1,713	2,022	1,794	1,754	1,623
キャッシュ・フロー * 1	百万円	Cash flow	Millions of yen	3,157	1,913	4,712	2,960	3,856
研究開発費	百万円	R&D expenses	Millions of yen	2,638	2,885	3,210	3,254	3,129
売上高比	%	Ratio to net sales	%	8.1	10.5	9.8	10.2	9.5

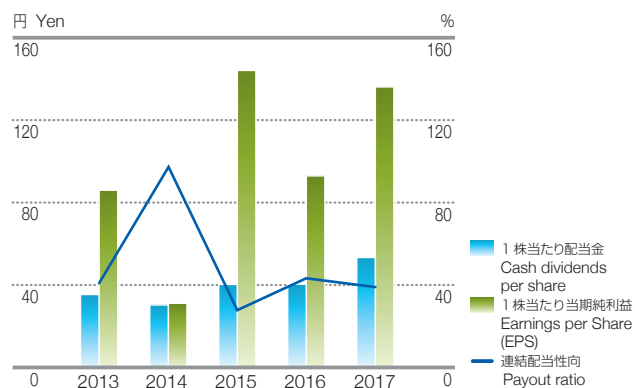
* 1 キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 配当金

Note: Cash flow = Profit attributable to owners of parent + Depreciation - Dividends

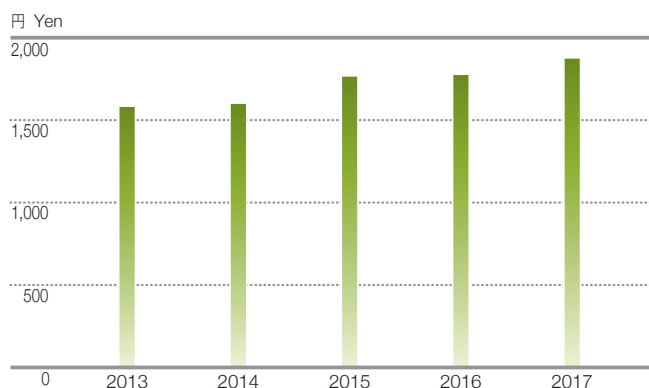
投資指標 Per Share Data and Others

1株当たり配当金/連結配当性向 Cash Dividends per Share, Payout Ratio

1株当たり当期純利益 Earnings per Share (EPS)

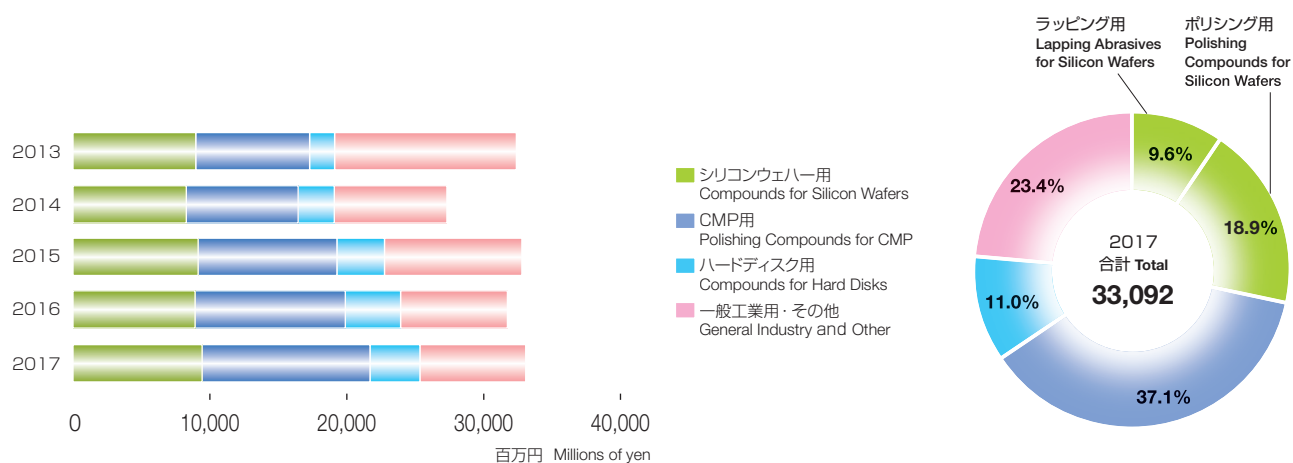


1株当たり純資産 Book Value per Share (BPS)



3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				2013	2014	2015	2016	2017
1株当たり配当金	円	Cash dividends per share	Yen	35.00	30.00	40.00	40.00	53.00
連結配当性向	%	Payout ratio	%	40.9	97.3	27.8	43.2	39.0
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	Earnings per share	Yen	85.68	30.82	143.79	92.63	135.77
1株当たり純資産 (BPS)	円	Book value per share	Yen	1,579.79	1,598.32	1,763.88	1,774.30	1,872.91

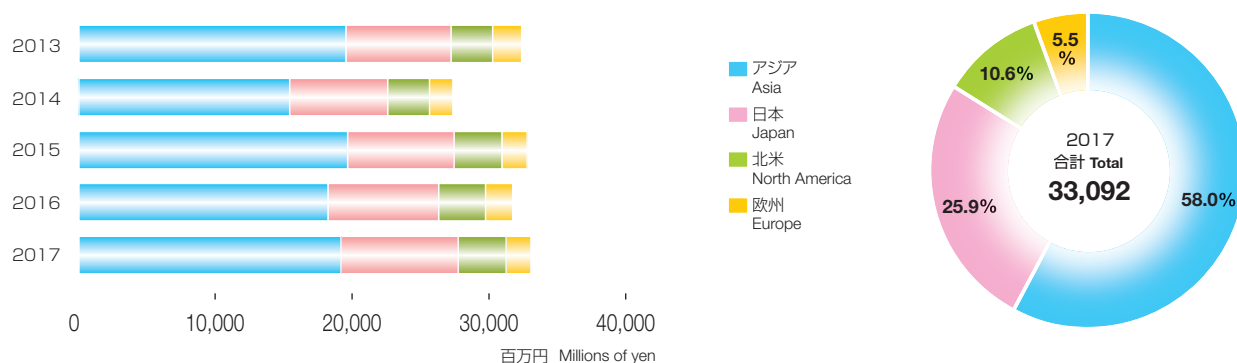
用途別製品売上高 Sales by Application



3月31日終了の各年度
Fiscal years ended March 31
百万円 Millions of yen

		2013	2014	2015	2016	2017
シリコンウェハー用	Compounds for Silicon Wafers	8,973	8,330	9,148	8,925	9,439
CMP用	Polishing Compounds for CMP	8,323	8,224	10,143	10,980	12,270
ハードディスク用	Compounds for Hard Disks	1,826	2,658	3,478	4,041	3,650
一般工業用・その他	General Industry and Other	13,288	8,280	10,044	7,809	7,733
合計	Total	32,412	27,492	32,815	31,755	33,092

地域別売上高 Sales by Region



3月31日終了の各年度
Fiscal years ended March 31
百万円 Millions of yen

		2013	2014	2015	2016	2017
アジア	Asia	19,542	15,490	19,667	18,228	19,185
日本	Japan	7,696	7,208	7,799	8,106	8,584
北米	North America	3,046	3,075	3,500	3,431	3,507
欧州	Europe	2,127	1,718	1,848	1,989	1,814
合計	Total	32,412	27,492	32,815	31,755	33,092

連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheet

百万円 Millions of yen

		3月31日現在 As of March 31	2013	2014	2015	2016	2017
資産の部	Assets						
流動資産	Current assets						
現金及び預金	Cash and deposits		14,023	12,709	18,390	19,320	24,332
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable		6,021	5,780	6,487	6,669	7,239
有価証券	Securities		5,109	5,106	4,805	1,999	500
たな卸資産	Inventories		5,856	5,107	5,606	5,383	5,721
繰延税金資産	Deferred tax assets		610	393	690	448	544
その他	Other		285	825	182	1,713	302
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts		(31)	(25)	(28)	(11)	(17)
流動資産合計	Total current assets		31,877	29,898	36,134	35,525	38,623
固定資産	Non-current assets						
有形固定資産	Property, plant and equipment						
建物及び構築物（純額）	Buildings and structures, net		8,197	7,779	7,913	7,341	7,262
機械装置及び運搬具（純額）	Machinery, equipment and vehicles, net		2,130	1,665	1,384	1,027	1,105
土地	Land		3,402	3,410	3,425	3,418	3,418
建設仮勘定	Construction in progress		204	167	120	809	1,070
その他（純額）	Other, net		1,511	1,547	1,302	1,081	778
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment		15,445	14,570	14,146	13,680	13,635
無形固定資産	Intangible assets		608	593	710	686	509
投資その他の資産	Investments and other assets						
投資有価証券	Investment securities		115	126	247	525	709
繰延税金資産	Deferred tax assets		18	176	154	164	120
その他	Other		1,470	1,515	522	112	109
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts		(198)	(232)	(124)	(9)	(9)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets		1,406	1,586	799	793	930
固定資産合計	Total non-current assets		17,460	16,750	15,656	15,159	15,075
資産合計	Total assets		49,337	46,648	51,790	50,684	53,699

		3月31日現在 As of March 31	2013	2014	2015	2016	2017
負債の部	Liabilities						
流動負債	Current liabilities						
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable - trade		3,173	2,713	3,319	2,703	3,226
未払法人税等	Income taxes payable		1,605	56	763	263	866
賞与引当金	Provision for bonuses		679	554	947	785	1,002
その他	Other		2,610	1,389	1,719	1,853	1,815
流動負債合計	Total current liabilities		8,068	4,713	6,750	5,605	6,911
固定負債	Non-current liabilities						
繰延税金負債	Deferred tax liabilities		31	13	13	8	7
退職給付引当金	Provision for retirement benefits		172	—	—	—	—
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability		—	389	311	526	579
その他	Other		34	23	20	19	37
固定負債合計	Total non-current liabilities		238	427	345	554	623
負債合計	Total liabilities		8,307	5,140	7,096	6,160	7,535
純資産の部	Net assets						
株主資本	Shareholders' equity						
資本金	Capital stock		4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus		5,069	5,069	5,038	5,038	5,038
利益剰余金	Retained earnings		37,160	37,052	38,836	40,042	41,013
自己株式	Treasury shares		(5,711)	(5,711)	(5,379)	(5,725)	(5,108)
株主資本合計	Total shareholders' equity		41,272	41,163	43,248	44,109	45,697
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income		(294)	295	1,446	414	466
新株予約権	Subscription rights to shares		52	48	—	—	—
純資産合計	Total net assets		41,030	41,507	44,694	44,523	46,164
負債純資産合計	Total liabilities and net assets		49,337	46,648	51,790	50,684	53,699

連結損益計算書

Consolidated Statement of Income

		百万円 Millions of yen				
		3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				
		2013	2014	2015	2016	2017
売上高	Net sales	32,412	27,492	32,815	31,755	33,092
売上原価	Cost of sales	21,116	18,262	19,887	19,353	19,568
売上総利益	Gross profit	11,295	9,230	12,927	12,402	13,524
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,798	7,929	8,799	9,099	9,246
営業利益	Operating profit	3,496	1,300	4,128	3,302	4,278
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	70	62	46	28	25
その他	Other non-operating income	326	215	459	68	247
営業外収益合計	Total non-operating income	396	277	506	97	273
営業外費用	Non-operating expenses	50	42	39	58	31
経常利益	Ordinary profit	3,843	1,535	4,596	3,342	4,519
特別利益	Extraordinary profit	6	3	48	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	253	—	—	18
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	3,849	1,285	4,645	3,342	4,500
法人税、住民税及び事業税	Income taxes—current	1,754	384	1,287	733	1,282
法人税等調整額	Income taxes—deferred	(152)	100	(338)	262	(132)
非支配株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to non-controlling interests	25	—	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	2,222	799	3,695	2,346	3,350

連結包括利益計算書

Statement of Consolidated Comprehensive Income

		百万円 Millions of yen				
		3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				
		2013	2014	2015	2016	2017
当期純利益	Profit	2,247	799	3,695	2,346	3,350
その他の包括利益	Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	11	2	85	(11)	132
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	1,204	680	1,048	(920)	(124)
退職給付に係る調整額	Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	—	—	17	(100)	44
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	1,216	682	1,151	(1,031)	52
包括利益	Comprehensive income	3,464	1,482	4,846	1,314	3,402
(内訳)	Breakdown					
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent	3,403	1,482	4,846	1,314	3,402
非支配株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to non-controlling interests	60	—	—	—	—

連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated Statement of Cash Flows

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各年度 Fiscal years ended March 31				
		2013	2014	2015	2016	2017
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities					
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	3,849	1,285	4,645	3,342	4,500
減価償却費	Depreciation	1,713	2,022	1,794	1,754	1,623
減損損失	Impairment loss	—	253	—	—	—
売上債権増減額（増加）	Decrease (increase) in notes and accounts receivable - trade	697	394	(495)	(421)	(669)
仕入債務増減額（減少）	Increase (decrease) in notes and accounts payable - trade	(89)	(608)	442	(421)	570
たな卸資産増減額（増加）	Decrease (increase) in inventories	644	945	(281)	23	(398)
その他	Other	591	(813)	332	14	614
小計	Subtotal	7,407	3,479	6,438	4,291	6,241
利息及び配当金の受取額	Interest and dividend income received	66	77	57	38	31
利息の支払額	Interest expenses paid	(0)	—	(0)	—	—
法人税等の支払額	Income taxes paid	(233)	(2,512)	(644)	(1,519)	(779)
法人税等の還付額	Income taxes refund	345	—	641	59	291
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	7,585	1,044	6,491	2,869	5,785
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities					
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	(3,017)	(2,223)	(3,719)	—	—
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	2,912	2,517	3,993	2,969	—
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	(3,106)	(4,107)	(2,800)	(2,999)	—
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	1,300	4,100	3,602	3,300	1,500
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	(2,370)	(1,597)	(722)	(990)	(1,531)
その他	Other	(622)	(139)	(31)	(655)	(7)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	(4,904)	(1,450)	322	1,623	(38)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities					
長期借入金の返済による支出	Repayments of long-term loans payable	(41)	—	—	—	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	(778)	(907)	(778)	(1,140)	(1,118)
その他	Other	(7)	(8)	(909)	(1,504)	509
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	(827)	(916)	(1,687)	(2,644)	(608)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	576	303	309	(453)	(127)
現金及び現金同等物の増加（減少）額	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	2,429	(1,019)	5,436	1,394	5,011
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	11,579	14,009	12,990	18,426	19,820
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	14,009	12,990	18,426	19,820	24,832

会社データ

Corporate Data

商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	827 (単体 Non-Consolidated 568)

役員 Board of Directors

2017年6月23日現在 (As of June 23, 2017)

代表取締役社長 President	関 敬史 Keishi Seki
常務取締役 Director	伊藤 広一 Hirokazu Ito
取締役 Director	鈴木 彰 Akira Suzuki
取締役 Director	大脇 寿樹 Toshiki Owaki
取締役 Director	鈴木 勝弘 Katsuhiko Suzuki
取締役 Director	川下 政美* Masami Kawashita
取締役 Director	浅井 侯序* Yoshitsugu Asai
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	藤川 佳明 Yoshiaki Fujikawa
監査役 Corporate Auditor	高橋 正彦** Masahiko Takahashi
監査役 Corporate Auditor	岡野 勝** Masaru Okano

(* 印は社外取締役)
(** 印は社外監査役)

Note: * indicates outside directors
** indicates outside corporate auditors

沿革 History

日付	内容	Date	Event
1950年8月	不二見研磨材工業所を創立し、人造精密研磨材の生産を開始	August 1950	Founded Fujimi Abrasives and started production of synthetic precision abrasives.
1953年3月	不二見研磨材工業株式会社を設立	March 1953	Established Fujimi Abrasives Manufacturing Co., Ltd.
1957年	東京通信工業(株)(現ソニー(株))のゲルマニウム半導体基板用研磨材ニーズに対応	1957	Supplied lapping abrasives for germanium semiconductor substrates to Tokyo Tsushin Kogyo, the predecessor of Sony Corporation.
1967年7月	シリコンウェハー用ポリシング材[GLANZOX]を発表	July 1967	Announced the development of GLANZOX polish for silicon wafers.
1977年1月	プラスチックレンズ用研磨材[POLIPLA]を生産開始	January 1977	Began manufacturing POLIPLA plastic lens polishing compounds.
1981年	[COMPOL]シリーズを開発	1981	Developed the "COMPOL" series.
1990年11月	ディスク用ポリシング材[DISKLITE]シリーズを開発	November 1990	Developed the DISKLITE series, the first polishing compounds developed especially for memory disks.
1995年4月	CMP用スラリー[PLANERLITE]シリーズを開発	April 1995	Developed the PLANERLITE series of CMP slurries.
2001年1月	耐衝撃WCサーメット溶射材[SURPREX W2010X]を発表	January 2001	Introduced the SURPREX-W2010X, new WC cermet thermal spraying composites of enhanced impact resistance.
2002年3月	FUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2002	FUJIMI AMERICA INC.* won the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2002年10月	世界初、HVOF[高速フレーム溶射]による微粉末溶射システムの確立に成功	October 2002	Successfully developed the world's first ultra-fine-grain thermal spray system employing a high velocity oxy-fuel (HVOF) process.
2003年3月	当社およびFUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2003	FUJIMI INCORPORATED and FUJIMI AMERICA INC.* received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2004年3月	FUJIMI CORPORATIONが、インテル社の「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インブルーメント(SCQI)賞」を受賞	March 2004	FUJIMI CORPORATION received the Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2007年2月	東証一部、名証一部に同時上場	February 2007	Listed Fujimi's shares on the Tokyo Stock Exchange First Section and Nagoya Stock Exchange First Section.
2008年7月	FUJIMI CORPORATIONがAMD社の「World Class Supplier Pathfinder Award 2007」を受賞	July 2008	FUJIMI CORPORATION received the World Class Supplier Pathfinder Award 2007 from AMD.
2009年11月	研磨に適した新しい粒子「角状ナノアルミナ」の開発に成功	November 2009	Successfully developed "angular nano-aluminium" as an abrasive material.
2010年3月	世界初、500℃から成膜可能な超硬溶射材料の開発に成功	March 2010	Successfully developed the world's first tungsten carbide powders applicable to low temperature spray processes of 500°C.
2011年4月	航空・宇宙・防衛 品質マネジメントシステム(JIS Q 9100)認証を取得(溶射材)	April 2011	Obtained JIS Q 9100 quality management certification for aircraft, space and defense (for thermal spray materials).
2013年12月	TSMC 社より「Excellent Performance Award(優秀賞)」を受賞	December 2013	FUJIMI INCORPORATED received the Excellent Performance Award from TSMC.
2015年3月	FUJIMI CORPORATIONがインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2015	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2016年3月	FUJIMI CORPORATIONがインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2016	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2017年3月	FUJIMI CORPORATIONがインテル社の「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インブルーメント(SCQI)賞」を受賞	March 2017	FUJIMI CORPORATION received the Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.

* FUJIMI AMERICA INC.は2003年7月にFUJIMI CORPORATIONと合併し、商号をFUJIMI CORPORATIONに変更しました。

* FUJIMI AMERICA INC. merged with FUJIMI CORPORATION in 2003 July and changed the business name to FUJIMI CORPORATION.

株式情報 Stock Information

大株主一覧 Leading Shareholders

2017年3月31日現在 (As of March 31, 2017)

株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Shareholding ratio
株式会社フジミインコーポレーテッド 有限会社コマ	FUJIMI INCORPORATED (Treasury Stock) Koma Co.,Ltd.	4,051 3,743	14.1 13.0
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust account)	1,454	5.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust account)	1,337	4.6
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	938	3.2
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	717	2.4
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.4
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	639	2.2
フジミ取引先持株会	Fujimi suppliers' stock ownership program	621	2.1

(注) 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。

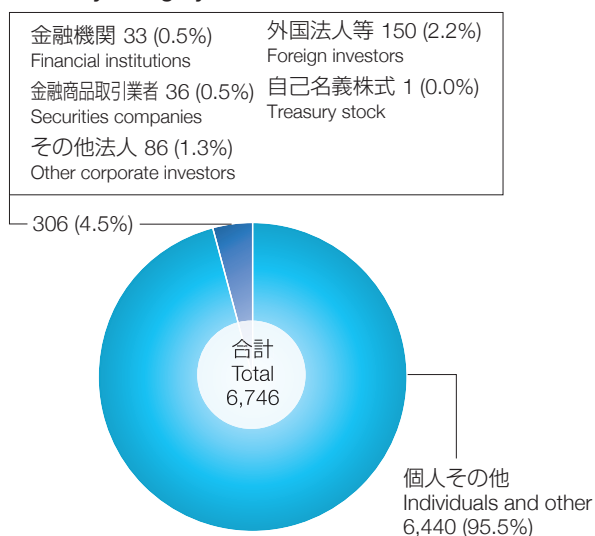
Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is omitted after the second decimal place.

所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

2017年3月31日現在 (As of March 31, 2017)

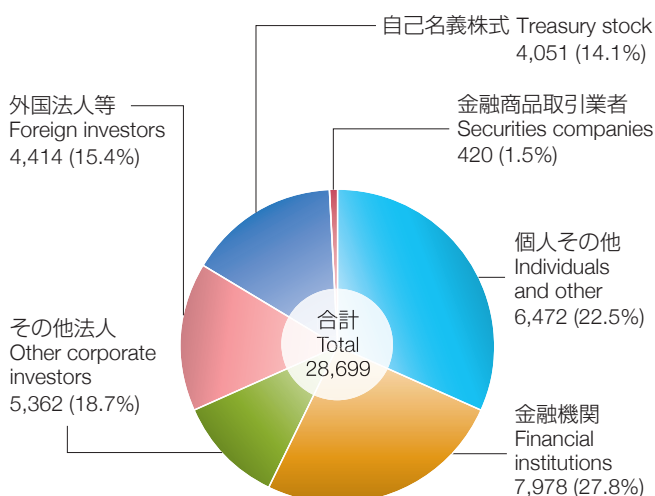
所有者別株主数 (人)

Shareholders by Category (Number of Shareholders)



所有者別持株数 (千株)

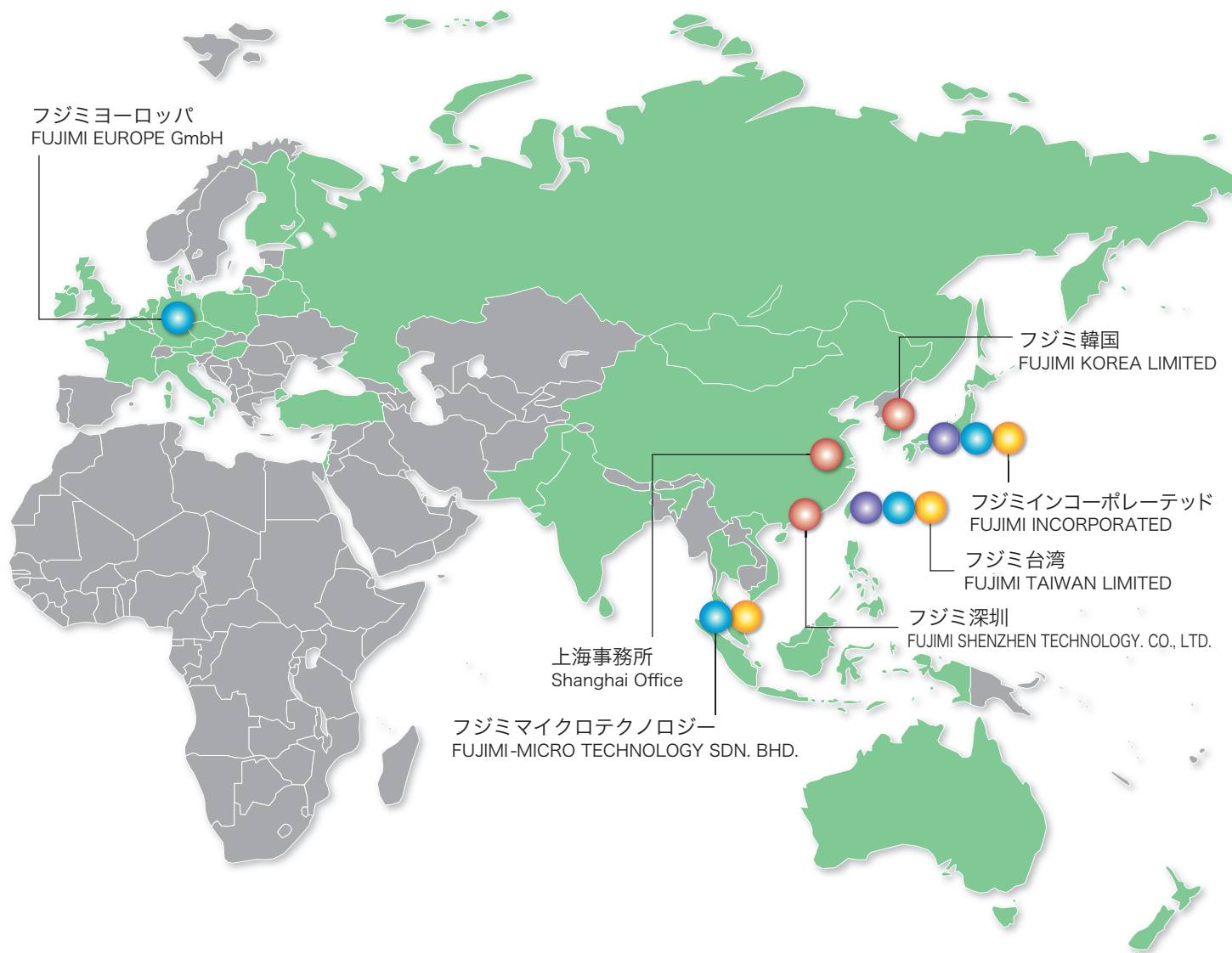
Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



発行済株式の推移 Common Stock Issues

日付 Date	摘要 Type of Issue	発行済株式数 (千株) Shares Outstanding (Thousands of Shares)
1992年2月1日 February 1, 1992	第三者割当増資 Allotment of new shares to third parties	245
1992年11月20日 November 20, 1992	1株につき2株の株式分割 (無償) 2-for-1 stock split	491
1993年9月27日 September 27, 1993	新株引受権の権利行使 Exercise of warrants	509
1994年5月20日 May 20, 1994	1株につき2株の株式分割 (無償) 2-for-1 stock split	1,019
1994年8月4日 August 4, 1994	500円額面株式1株を50円額面株式 10株に分割 Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	10,195
1995年4月18日 April 18, 1995	一般公募増資 Public offering of common stock	10,995
1996年5月20日 May 20, 1996	1株につき1.1株の株式分割 (無償) 1.1-for-1 stock split	12,094
1996年10月1日 October 1, 1996	一般公募増資 Public offering of common stock	12,894
1997年5月20日 May 20, 1997	1株につき1.1株の株式分割 (無償) 1.1-for-1 stock split	14,184
1998年5月20日 May 20, 1998	1株につき1.1株の株式分割 (無償) 1.1-for-1 stock split	15,602
2001年11月22日 November 22, 2001	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	15,349
2005年5月20日 May 20, 2005	1株につき2株の株式分割 (無償) 2-for-1 stock split	30,699
2014年11月4日 November 4, 2014	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	29,699
2016年6月15日 June 15, 2016	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	28,699

グローバル展開 Global Expansion



事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場 Headquarters / Biwajima Plant
〒452-8502
愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu,
Aichi 452-8502, Japan
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場 Inazawa Plant
〒492-8329
愛知県稲沢市西島町市助戸 1-1
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa,
Aichi 492-8329, Japan

各務原工場 Kakamigahara Plant
〒504-0927
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara,
Gifu 504-0927, Japan

各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,
Gifu 509-0103, Japan

溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,
Gifu 509-0103, Japan

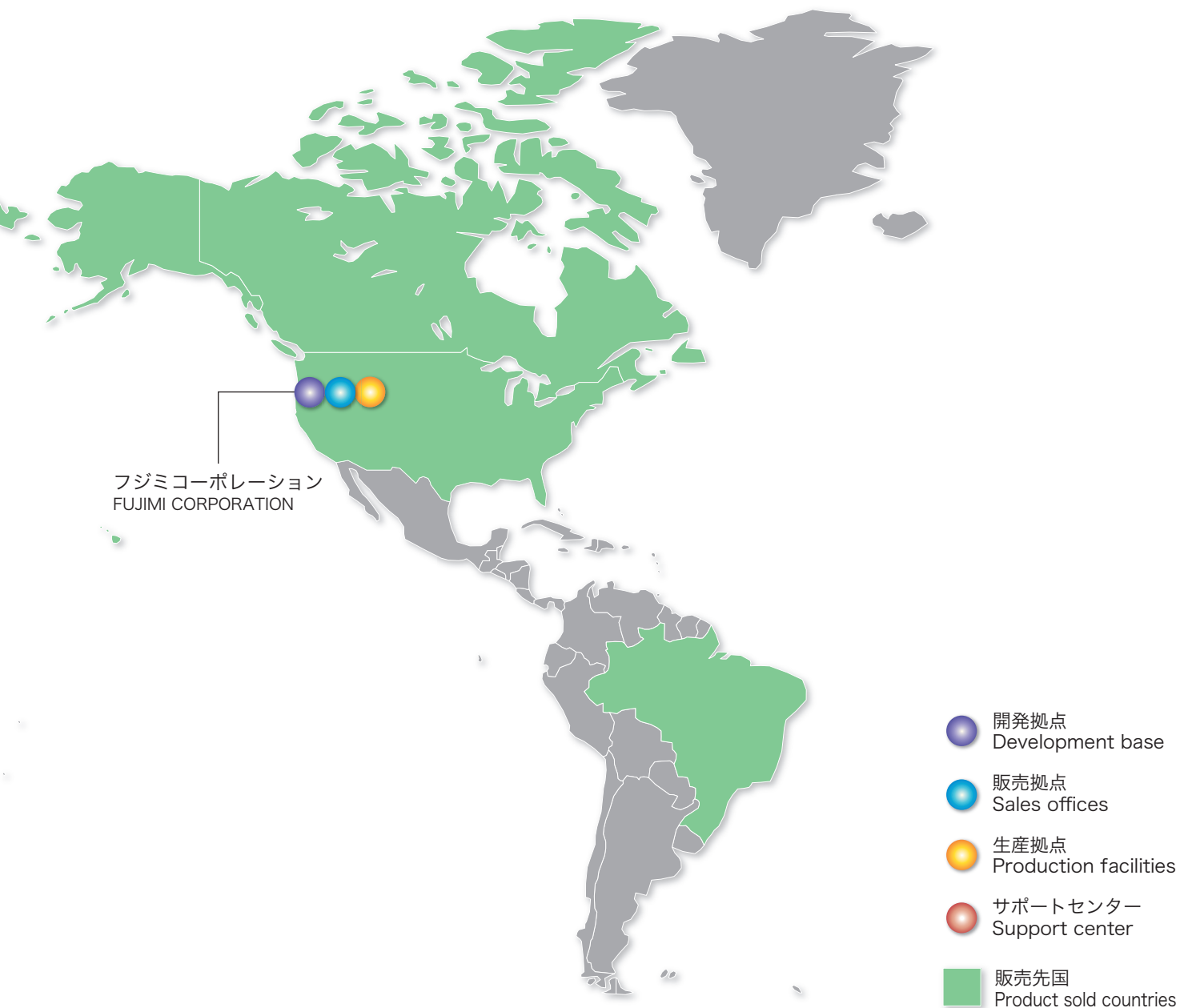
研究開発センター R&D Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8
8, Technoplaza-1, Kakamigahara,
Gifu 509-0109, Japan

先端技術研究所 Advanced Technology Research Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-22
22, Technoplaza-1, Kakamigahara,
Gifu 509-0109, Japan

物流センター Logistics Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1
1, Technoplaza-4, Kakamigahara,
Gifu 509-0109, Japan

東京事務所 Tokyo Office
〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-2-8
いちご内神田ビル 7F
7th Floor, ICHIGO Uchikanda Bldg., 2-8,
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0047, Japan

上海事務所 Shanghai Office
上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室
317B, German Center, 88 Keyuan Road,
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203,
Shanghai, China



連結子会社 Consolidated subsidiary

フジミコーポレーション (米国)

FUJIMI CORPORATION

11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A.
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

フジミマイクロテクノロジー (マレーシア)

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.

Lot 13, Jalan Hi-Tech 3, Industrial Zone Phase 1
Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia
Phone: +60-4-403-3700 Fax: +60-4-403-3900

フジミヨーロッパ (ドイツ)

FUJIMI EUROPE GmbH

Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany
Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20

フジミ台湾 (台湾)

FUJIMI TAIWAN LIMITED

No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township,
Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)
Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567

フジミ韓国 (韓国)

FUJIMI KOREA LIMITED

RM1203 ParkView, Jungja-Dong 6, BunDang-Gu,
Seongnam-Shi, Kyeonggi-Do, Korea
Phone: +82-31-726-3555 Fax: +82-31-726-3556

フジミ深圳 (中国)

FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY. CO., LTD.

13G-1, South Maple Building, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China
Phone: +86-755-2267-5151 Fax: +86-755-2267-5162

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。

Copyright (C) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.
Printed in Japan